

# 内蒙古低温键合机

生成日期：2025-10-29

EVG®520IS晶圆键合系统■拥有EVG®501和EVG®510键合机的所有功能■200mm的单个或者双腔自动化系统■自动晶圆键合流程和晶圆替代转移■集成冷却站，实现高产量EVG®540自动键合系统■300mm单腔键合室■自动处理多达4个键合卡盘■模块化键合室■自动底侧冷却EVG®560自动晶圆键合系统■多达4个键合室，满足各种键合操作■自动装卸键合室和冷却站■远程在线诊断■自动化机器人处理系统，用于机械对准的自动盒式磁带晶圆键合■工作站式布局，适用于所有键合工艺的设备配置EVG®GEMINI®自动化生产晶圆键合系统在最小的占地面积上，同时利用比较/高精度的EVGSmaiewNT技术，前/列的GEMINI大批量生产系统，并结合了自动光学对准和键合操作。有关更多详/细信息，请参/阅我们的GEMINI手册□EVG键合机跟应用相对应，键合方法一般分类页是有或没有夹层的键合操作。内蒙古低温键合机

## EVG805 晶圆解键合系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司

键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®805解键合系统用途：薄晶圆解键合□EVG805是半自动系统，用于剥离临时键合和加工过的晶圆叠层，该叠层由器件晶圆，载体晶圆和中间临时键合胶组成。该工具支持热剥离或机械剥离。可以将薄晶圆卸载到单个基板载体上，以在工具之间安全可靠地运输。特征：开放式胶粘剂平台解键合选项：热滑解键合解键合机械解键合程序控制系统实时监控和记录所有相关过程参数薄晶圆处理的独特功能多种卡盘设计，可支撑最大300mm的晶圆/基板和载体高形貌的晶圆处理技术数据晶圆直径（基板尺寸）晶片最大300mm高达12英寸的薄膜组态1个解键合模块选件紫外线辅助解键合高形貌的晶圆处理不同基板尺寸的桥接能力内蒙古低温键合机GEMINI FB XT采用了新的Smart View NT3键合对准器，是专门为<50 nm的熔融和混合晶片键合对准要求而开发的。

## EVG620 BA 晶圆键合自动对准系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司  
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®560自动晶圆键合机系统全自动晶圆键合系统，用于大批量生产特色技术数据EVG560自动化晶圆键合系统最多可容纳四个键合室，并具有各种键合室配置选项，适用于所有键合工艺和最大300mm的晶圆。EVG560键合机基于相同的键合室设计，并结合了EVG手动键合系统的主要功能以及增强的过程控制和自动化功能，可提供高产量的生产键合。机器人处理系统会自动加载和卸载处理室。特征全自动处理，可自动装卸键合卡盘多达四个键合室，用于各种键合工艺与包括Smaiew的EVG机械和光学对准器兼容同时在顶部和底部快速加热和冷却自动加载和卸载键合室和冷却站远程在线诊断技术数据最大加热器尺寸150、200、300毫米装载室使用5轴机器人最大/高键合模块4个。

EVG®810LT技术数据晶圆直径（基板尺寸）50-200、100-300毫米LowTemp™等离子活化室工艺气体：2种标准工艺气体N<sub>2</sub>和O<sub>2</sub>通用质量流量控制器：自校准（高达20.000sccm）真空系统9x10<sup>-2</sup>mbar腔室的打开/关闭：自动化腔室的加载/卸载：手动（将晶圆/基板放置在加载销上）可选功能：卡盘适用于不同的晶圆尺寸无金属离子活化混合气体的其他工艺气体带有涡轮泵的高真空系统9x10<sup>-3</sup>mbar基本压力符合LowTemp™等离子活化粘结的材料系统Si/Si/Si/Si/Si热氧化/Si热氧化/Si热氧化/TEOS/TEOS热氧化）绝缘体锗GeO<sub>2</sub>的Si/GeSi/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>玻璃（无碱浮法）：硅/玻璃，玻璃/玻璃化合物半导体GaAs/GaP/InP聚合物PMMA环烯烃聚合物用户可以使用上述和其他材料的“最佳已知方法”配方（可根据要求提供完整列表）EVG键合机软件是基于Windows的图形用户界面的设计，注重用户友好性，可轻松引导操作员完成每个流程步骤。

## EVG610 BA 晶圆键合对准系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司  
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®620BA键合机选件 自动对准 红外对准，用于内部基板键对准 NanoAlign®包增强加工能力 可与系统机架一起使用 掩模对准器的升级可能性 技术数据 常规系统配置 桌面 系统机架：可选 隔振：被动 对准方法 背面对准 $\pm 2\mu\text{m}3\sigma$  透明对准 $\pm 1\mu\text{m}3\sigma$  红外校准：选件 对准阶段 精密千分尺：手动 可选：电动千分尺 楔形补偿：自动 基板/晶圆参数 尺寸：2英寸，3英寸，100毫米，150毫米 厚度：0.1-10毫米 叠/高堆叠高度：10毫米 自动对准 可选的 处理系统 标准：3个卡带站 可选：最多5个站键合机供应商EVG拥有超过25年的晶圆键合机制造经验，拥有累计2000多年晶圆键合经验的员工。内蒙古低温键合机

EVG的EVG®501 / EVG®510 / EVG®520 IS这几个型号用于研发的键合机。内蒙古低温键合机

EVG®820层压系统 将任何类型的干胶膜（胶带）自动无应力层压到晶圆上 特色 技术数据 EVG820层压站用于将任何类型的干胶膜自动，无应力地层压到载体晶片上。这项独特的层压技术可对卷筒上的胶带进行打孔，然后将其对齐并层压到晶圆上。该材料通常是双面胶带。利用冲压技术，可以自由选择胶带的尺寸和尺寸，并且与基材无关。 特征 将任何类型的干胶膜自动，无应力和无空隙地层压到载体晶片上 在载体晶片上精确对准的层压 保护套剥离 干膜层压站可被集成到一个EVG®850TB临时键合系统 技术数据 晶圆直径（基板尺寸） 高达300毫米 组态 1个打孔单元 底侧保护衬套剥离 层压 选件 顶侧保护膜剥离 光学对准 加热层压内蒙古低温键合机

岱美仪器技术服务（上海）有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展EVG,Filmetrics, MicroSense, Herz, Herzan, Film

Sense, Polyteknik, 4D, Nanotronics, Subnano, Bruker, FSM, SHB的品牌。我公司拥有强大的技术实力，多年来一直专注于磁记录、半导体、光通讯生产及测试仪器的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易、转口贸易，商务信息咨询服务 的发展和创新，打造高指标产品和服务。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的半导体工艺设备，半导体测量设备，光刻机 键合机，膜厚测量仪，从而使公司不断发展壮大。